

2015年12月期第3四半期 決算説明資料

株式会社RS Technologies
東証マザーズ：3445

1

13. Nov. 2015



注意事項

- 当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性がございます。
- 本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

2

13. Nov. 2015



目次

2015年12月期第3四半期決算情報	P. 4- 7
中・長期的な経営方針	P. 8-13
参考資料	P.14-22

2015年12月期第3四半期 決算情報

2015年12月期第3四半期決算情報 ☆ サマリー ☆

■ 第3四半期の業績は台湾の稼働が本稼働が遅れているものの、
おおむね事業計画の進捗通り ■

単位：百万円

	2015年12月期 第3四半期 (2015年1~9月)	2014年12月期 第3四半期 (2014年1~9月)	前四半 期累計 同期比	2015年12月期 予想 (2015年1~12月)	進捗率
売上高	3,913	3,386	115.5%	5,486	71.3%
営業利益	848	814	104.1%	927	91.4%
営業利益率	21.6%	24.0%	▲2.4pt	16.9%	-
経常利益	720	762	94.4%	849	84.8%
経常利益率	18.4%	22.5%	▲4.1pt	15.5%	-
当期(四半期) 純利益	212	454	46.6%	420	50.4%

※2015年12月期予想数値は、2015年3月24日付の「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」で公表しました数値と変更はございません。

2015年12月期第3四半期決算情報 — 連結損益計算書 —

【当四半期業績のポイント】

単位：百万円

	2015年12月期	2014年12月期	
	第3四半期 (2015年1~9月)	第3四半期 (2014年1~9月)	比較増減
売上高	3,913	3,386	527
売上原価	2,525	2,104	421
販売費・一般管理費	539	467	72
営業利益	848	814	34
(%)	21.7%	24.0%	-2.4%
営業外損益	△ 127	△ 51	△ 76
経常利益	720	762	△ 42
(%)	18.4%	22.5%	-4.1%
特別損益	△ 248	-	△ 248
税引前当期利益	471	762	△ 291
法人税等	259	307	△ 48
当期利益	212	454	△ 242
(%)	5.4%	13.4%	-8.0%

売上高は、三本木の生産能力があがったことにより、前年同期比で15.5%増加。

営業利益は848百万円 営業利益率
21.7%

外貨建て債務が膨らんだ影響で、為替差損が発生し、

経常利益は720百万円 経常利益率
18.4%

2015年12月期第3四半期決算情報 — 連結貸借対照表 —

単位：百万円

	2015年度 第3四半期末	2014年度 年度末	比較増減
資産の部			
現金及び預金	1,588	1,190	398
売上債権	1,081	697	384
たな卸資産	558	524	34
未収入金	1	11	△ 10
その他流動資産	252	338	△ 86
有形固定資産	5,160	3,918	1,242
無形固定資産	11	15	△ 4
その他固定資産	87	130	△ 43
資産合計	8,738	6,824	1,914
負債の部			
支払手形及び買掛金	185	151	34
短期借入金	262	483	△ 221
1年内返済長期借入金	840	344	496
長期借入金	4,195	2,926	1,269
その他流動負債	438	1,315	△ 877
その他固定負債	274	9	265
計	6,194	5,228	966
純資産の部			
資本金	616	199	417
資本剰余金	616	199	417
利益剰余金	1,326	1,114	212
その他	△ 15	84	△ 99
計	2,544	1,596	948
負債・純資産合計	8,738	6,824	1,914

【主要科目のポイント】

■有形固定資産

増加。三本木工場に最新の設備を導入。本年6月より稼働。また、台湾でも既に取得は終えて、現在テスト稼働中。

■有利子負債

(短期借入金、1年内返済長期借入金、長期借入金)

増加。先端設備投資に係る借入実行済み。当第3四半期補助金(入金額2,443百万円)入金後に、2,732百万円返済予定。

(追加) 2015/8/14補助金を受領しましたので、銀行約定により9月末返済。

中・長期的な経営方針

中・長期的な経営方針

●今期のトピックス●
①事業計画通りの新設・増設による生産力拡大

②再生市場での当社のシェア拡大

③伸長する需要の取込み

④潜在的な再生市場の開拓

⑤中国半導体マーケットへの参入

2015/3/24 当社発表「成長可能性に関する説明資料」より一部抜粋

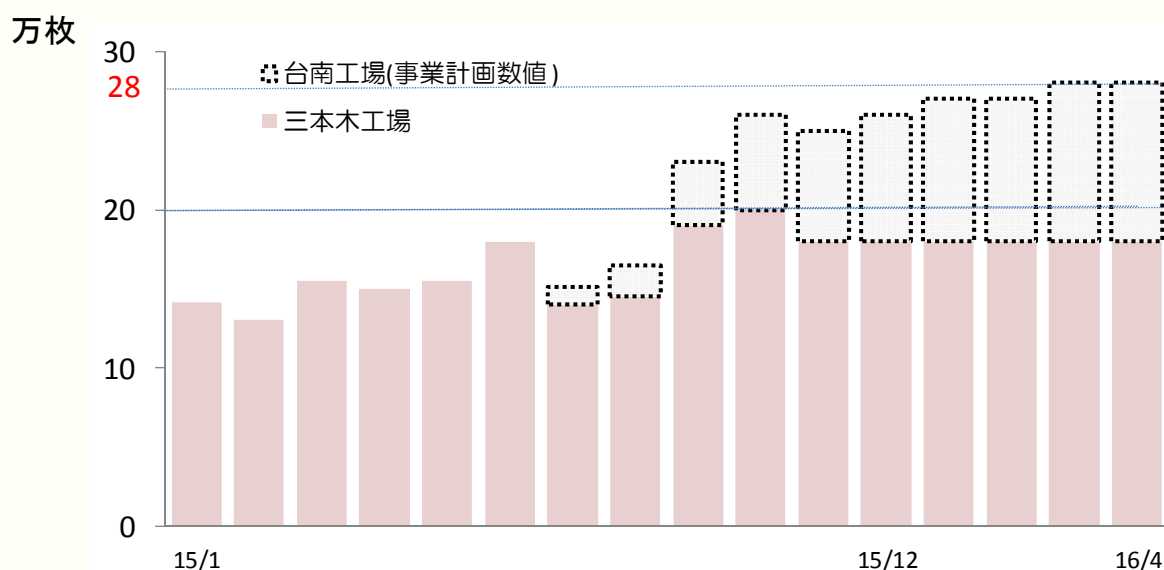
「事業計画通りの新設・増設による生産力拡大」

～●今期のトピックス●当社300mmウェー八月産生産能力推移～

	2015/6末時点	2015/9末時点	2016年度末予想
三本木工場 (宮城県大崎市)	18 万枚	18 万枚	18 万枚
台南工場 (台湾台南市)	- 万枚	- 万枚 (2015/9から テスト稼働済 み)	10 万枚
合 計	18 万枚	18 万枚	28 万枚

「事業計画通りの新設・増設による生産力拡大」

～●今期のトピックス●三本木工場と台南工場300mmウェーハ出荷枚数推移～



2015/1～2015/10は実績の出荷枚数 2015/11以降は見込の出荷枚数
 台湾はすでにテスト稼働を始めております。
 顧客先の認定待ちにより本稼働開始については未定とします。
 時期が明確になりましたら適時開示いたします。

2015年度中期計画の概要

単位：百万円

会計年度	2014/12 (実績)	2015/12 (計画)	2016/12 (計画)	2017/12 (計画)
売上高	4,566	5,486	7,276	7,442
営業利益	1,166	927	1,820	1,912
当期純利益	664	420	1,263	1,324

【前提】 (2015年度～2017年度)

為替
109.5 円/USドル

2015/3/24 当社発表「成長可能性に関する説明資料」より抜粋

2015年度中期計画の概要②

会計年度	2014/12 (実績)	2015/12 (計画)	2016/12 (計画)	2017/12 (計画)
R O E	45.0 %	14.5 %	30.3 %	24.1 %
自己資本比率	21.6 %	33.2 %	44.7 %	56.0 %

～直近本決算期 同業他社情報～ 注) 当社の直近本決算数値は上場前のため、2015/12月期予算数値を使用

	信越化学工業様 (2015/3月期 決算 短信より引用)	三益半導体工業様 (2015/5月期 決算 短信より引用)	SUMCO様 (2014/12月期 決算 短信より)	当社 (2015/12月期年度予 算より)	上場企業平均値 (当社調べ)
ROE	6.9 %	3.2 %	9.2 %	14.5 %	8.0 %
自己資本比率	79.9 %	71.7 %	36.2 %	33.2 %	50.0 %

※ROE=自己資本当期純利益率 (当期純利益÷自己資本)

※自己資本比率 (自己資本÷総資産)

ご参考

直近のIRトピックス

取締役事業本部長 本郷邦夫が
中国半導体関係協会の顧問就任

会社名 株式会社 RS Technologies
住所 東京都品川区大井1-23-1
Tel: 03-5799-7085
Fax: 03-5799-7086

2015年10月19日発表

関係各位

株式会社 RS Technologies 取締役事業本部長 本郷邦夫
集成回路材料産業革新戦略連盟
(The Integrated Circuit Materials Industry Innovative Alliance)
日本人初「特別顧問」就任

本社取締役事業本部長である本郷邦夫が中国の発展ある団体「集成回路材料産業革新戦略連盟」の特別顧問に就任しましたのでご通知します。
なお、本郷氏から本郷邦夫氏は、これまで以上に中国の半導体市場と日本の半導体技術をつなぐ役割を担うよう事業を進めてまいります。



<本件に関するお問い合わせ>
IR担当: 財務経理部 伊藤 智珠
TEL: 03-5799-7085 FAX: 03-5799-7086
E-mail: nit@rs-tec.jp

テクノロジーFast50 3位入賞
～売上高が直近4年で約13倍に急成長～

会社名 株式会社 RS Technologies
住所 東京都品川区大井1-23-1
Tel: 03-5799-7085
Fax: 03-5799-7086



プレスリリース 発表日: 【発表】

2015年10月20日発表

報道関係者各位

株式会社 RS Technologies テクノロジー企業ランキングプログラム
第13回「日本テクノロジー Fast50」で3位と上位入賞
～1296.38%の収益(売上高)成長を記録～

株式会社 RS Technologies (本社所在地: 東京都品川区大井1-23-1 3F)は、有価証券届出法人・メーカーが得意なテクノロジー・メディア・デジタル・コミュニケーション (以下、DIT) 業界の収益(売上高)成長率ランキング 第13回「日本テクノロジー Fast50」において、過去4年間の収益(売上高)成長率1296.38%を記録し、9位中3位を獲得いたしました。
<http://www.deloitte.com/jp/fast50>

日本テクノロジー Fast50は、グローバル・テクノロジー・スタートアップ (以下、DIT) が集約46ヶ国以上で定率・成長・アジア太平洋地域の3地域ごとに実施しているランキングプログラムの日本版で、DIT業界での成長性や成功のベンチマークとなっています。上記・上位入賞企業を問わず DIT 業界に含まれる企業からの応募をもち、直近4年間の収益(売上高)成長率の上位50社がランキングされます。プログラムの詳細は、<http://www.deloitte.com/jp/fast50>をご覧ください。

【テクノロジー Fast50プログラムについて】
Fast50は、国際会計事務所・グローバル・スタートアップ リミテッドのランキングプログラムの日本版であり、DIT 業界の企業を最大4ヶ国(収益(売上高)成長率で順位付け)し、目標を達成成長率としていることにより、企業規模による「成長性差別」を排除し、順位を公平にします。なお、Fast50の応募企業は、自動的に、アジア太平洋地域テクノロジー Fast500の候補企業となります。

【会社概要】
会社名: 株式会社 RS Technologies
証券コード: 2417 (東証1部)
設立: 2010年12月(創業開始: 2011年1月)
代表: 方永義
資本金: 61,645万円
本社所在地: 東京都品川区

<本件に関するお問い合わせ>
IR担当: 財務経理部 伊藤 智珠
TEL: 03-5799-7085 FAX: 03-5799-7086
E-mail: nit@rs-tec.jp



会社概要

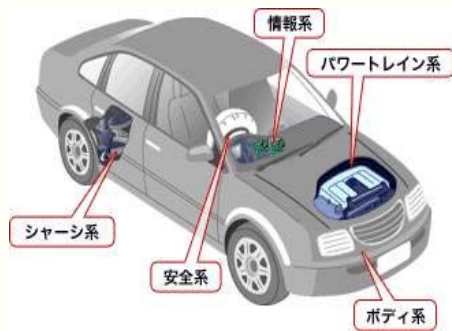
社名	株式会社 RS Technologies
本社	東京都品川区大井1-23-1 カクタビル 4F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
台南工場	No.1 Nanke 7th Rd., Southern Taiwan Science Park, Tainan City 74144 Taiwan
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
資本金	61,645万円 (2015年3月31日時点)
取締役	方永義、鈴木正行、本郷邦夫、近藤淳行 石黒正亨、李宗根、渡邊泰紀、内海忠
設立	2010年12月10日
操業開始	2011年1月1日
事業内容	半導体用シリコンウェーハの再生、加工、販売、 ソーラー売電 半導体製造設備・半導体部材販売



シリコンウェーハ再生事業-半導体とウェーハ

各種電気製品や自動車等の基幹部品となる半導体は円盤状のシリコンウェーハから作られます。
我々は**使用済みシリコンウェーハの再利用を目的として、精密加工を行う会社**です。

シリコンウェーハ再生事業-半導体の用途



スマホ・タブレット
 ・ウェアラブル・自動運転
 ・家・ビル・町・**M2M**・・・etc



世界の半導体の需要は

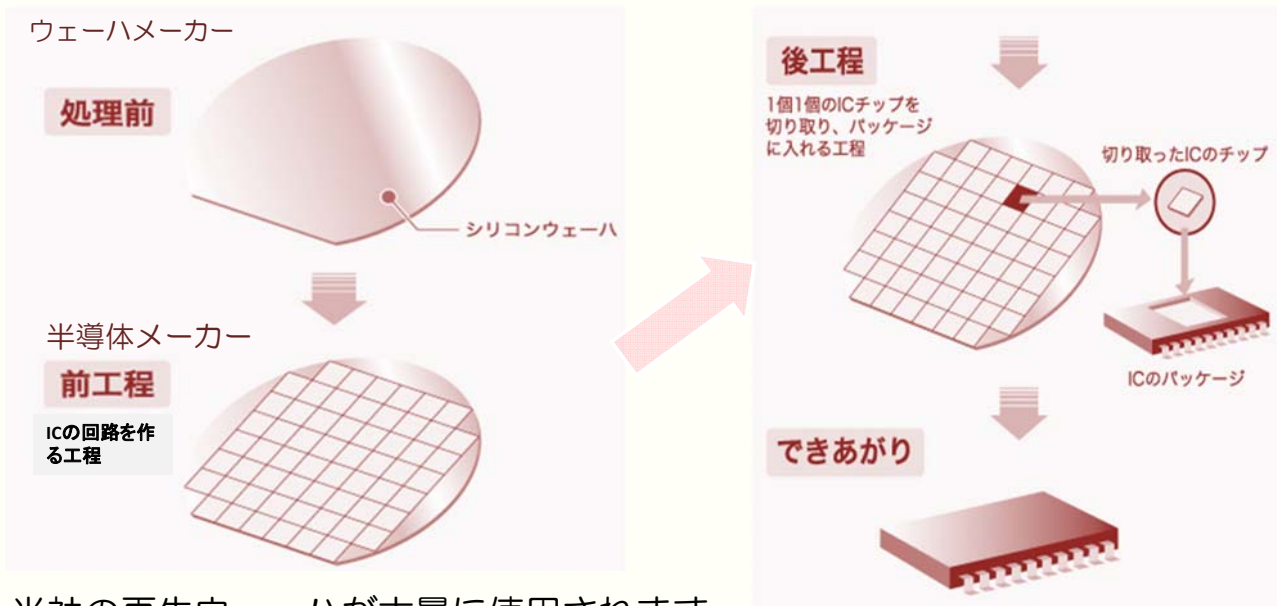
- ★ 世界の人口増
- ★ 新興国の経済発展
- ★ 先進国の
デバイス用途の多様化

により拡大



シリコンウェーハ再生事業-半導体製造概要

半導体製造のおおまかな流れ



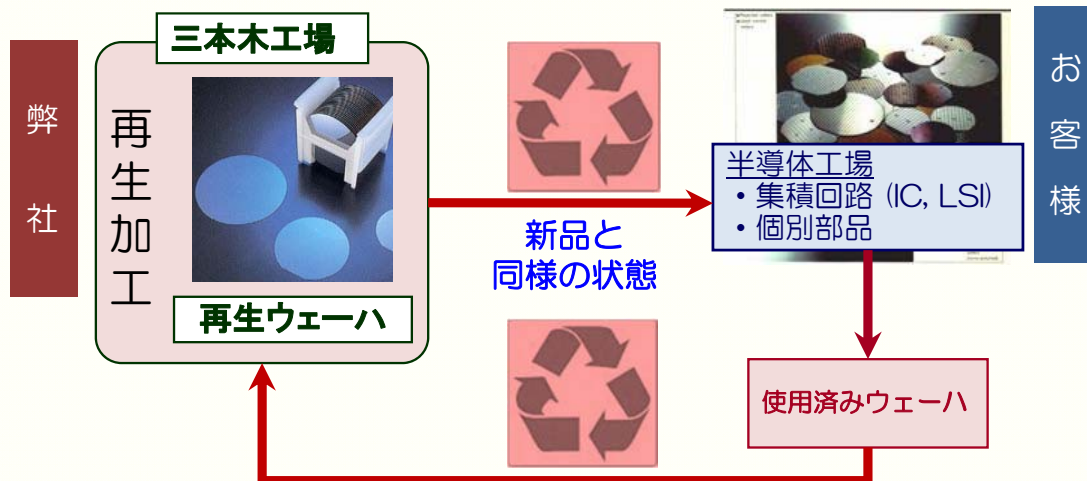
当社の再生ウェーハが大量に使用されます。

シリコンウェーハ再生事業-再生とは？

半導体工場では700を超える工程がありますが、各工程のプロセス評価、出来栄への評価のために『モニタウェーハ』が使用されます。これらのモニタウェーハは、1回～数回使用されると使用不可となりますが、弊社は、これらのウェーハをお預かりし、精密加工をすることで再利用が可能な新品と同様の状態に戻し、同じ用途で使用していただくサービスを提供しております。

再生ウェーハはシリコンウェーハ全使用量に対し、約21%の需要があります。

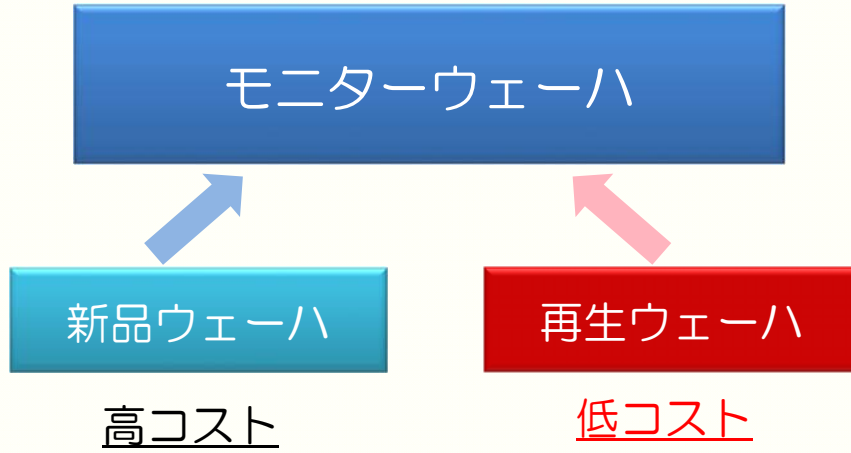
(SEMI 2012実績)



シリコンウェーハ再生事業-なぜ再生が必要か？

◇◇ なぜ再生ウェーハの需要があるのか？ ◇◇

◎一番の目的は、お客様の**コストダウン**のためです。



※環境負荷を減らすという目的もあります。

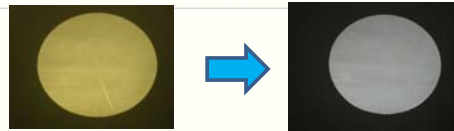
シリコンウェーハ再生事業

工程概要と 当社の強み

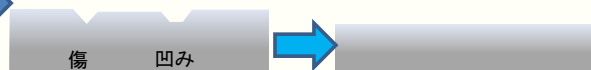


・強み①(すべての膜を剥離可能)
ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に→「再生回数が多い」→よりコストダウンが可能に。

★ラサ工業(化学)の特異技術を承継



・表面に付いているキズや凹凸を研磨(ポリッシング)により平滑にする



・強み②(金属不純物を除去)
ウェーハ表面の微細ゴミ、汚れ、を洗浄で取り除く
+ 金属不純物の除去
特に銅 (Cu) の汚染除去に強み

